

整理番号 507944JP02  
発送番号 117639  
発送日 平成16年 3月30日

## 拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2001-099042
起案日	平成16年 3月26日
特許庁審査官	田代 吉成 9448 4R00
特許出願人代理人	宮田 金雄(外 1名) 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

### 理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1乃至3  
引用文献1及び引用文献2  
備考

引用文献1の第1図及びその関連箇所を参照のこと。

本請求項に係る発明における「パッケージ」、「半導体素子」、「複数のリード」及び「半導体モジュール」は、引用文献1に記載の発明における「セラミックパッケージ基板」、「半導体チップ」、「側面の対向する2面にロー付けされた外リード」及び「半導体装置」にそれぞれ相当。

引用文献1に記載の発明において、リードとパッケージを接合するためのロウ材の有する位置よりも下側に設けられた段差よりも下側で、リードの開放端を曲げ成形することは、引用文献2の記載(第3図、第5図(a)及びその関連箇所。)に基づき当業者であれば適宜になし得るものと認められる。

請求項5  
引用文献1及び引用文献2  
備考

引用文献1に記載の発明において、引用文献2に記載の段差を適用した場合に、パッケージの底面が実装面に対し所定の空間を形成するように半田付けすることは、引用文献2の記載(第3図及びその関連箇所。)に基づき当業者であれば適宜になし得るものと認められる。

請求項6  
引用文献1及び引用文献2  
備考

引用文献1の記載は、半導体素子として光素子の適用を排除するものではないから、同文献に記載の発明において、光素子を採用することは、周知技術の単なる適用に過ぎないものと認められる。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

### 引 用 文 献 等 一 覧

1. 特開平4-69956号公報
2. 実願昭61-90677号(実開昭62-201941号)のマイクロフィルム

### 先行技術文献調査の記録

調査した分野 IPC第7版 H01L23/04

この先行技術文献調査の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

-----  
問い合わせ先

特許審査第三部（電子素材加工）

TEL 03(3581)1101 x. 3470

FAX 03(3580)6905